

深圳市景旺电子股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期 回报、采取填补措施及相关承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会的核准。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的等相关文件的规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。

为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承诺。现将公司本次公开发行可转债摊薄即期回报有关事项说明如下：

一、本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设和前提条件

1、假设公司于2017年12月31日之前完成本次发行，并于2018年6月份全部完成转股。该时间仅用于测算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影

响，最终以中国证监会核准后发行实际完成时间为准。

2、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

3、不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响。

4、本次公开发行募集资金总额为97,800.00万元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设本次可转债的转股价格为50.00元/股（实际转股价格根据公司募集说明书公告日前20个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

6、公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,745.90万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润52,105.69万元；假设2017年扣非前后归属于母公司所有者的净利润相比2016年度上升10%，并分别按照2018年扣非前后归属于母公司所有者的净利润相比2017年持平、上升10%进行测算。

上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年或2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

7、公司2016年度利润分配方案为以总股本40,800万股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利16,320万元，已于2017年6月6日实施完毕。公司2017年中期利润分配方案为以总股本40,800万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利8,160.00万元，计划于2017年9月实施完毕。假定2017年度、2018年度现金分红时间、金额与2016年度分红保持一致。2017年度及2018年度派发现金股利金额仅为预计数，不构成对派发现金股

利的承诺。

8、在预测公司发行后净资产时，不考虑可转债分拆增加的净资产，也未考虑净利润之外的其他因素对净资产的影响。

2017年12月31日归属于母公司所有者权益=2017年期初归属于母公司所有者权益+2017年归属于母公司所有者的净利润-本期现金分红金额；2018年12月31日归属于母公司所有者权益=2018年期初归属于母公司所有者权益+2018年归属于母公司所有者的净利润+转股增加的所有者权益-2017年度现金分红金额。

9、除可转债转股外，公司未发生其他导致股本变动的事项。

10、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

(二) 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2016年度 /2016年12 月31日	2017年度 /2017年12 月31日	2018年度/2018年12月31日				
		2017年净利 润相比2016 年增长10%	2018年净利润与上年持平		2018年净利润较上年增长 10%		
			2018年中期 全部转股	2018年中期 全部未转股	2018年中期 全部转股	2018年中期 全部未转股	
总股本(万股)	40,800.00	40,800.00	42,756.00	40,800.00	42,756.00	40,800.00	
归属于母公司所有者的权益(万元)	286,150.29	320,790.78	461,391.27	363,591.27	467,303.32	369,503.32	
归属于母公司的净利润(万元)	53,745.90	59,120.49	59,120.49	59,120.49	65,032.54	65,032.54	
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	52,105.69	57,316.26	57,316.26	57,316.26	63,047.88	63,047.88	
基本每股收益(元/股)	1.49	1.45	1.42	1.45	1.56	1.59	
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.45	1.38	1.38	1.52	1.52	
扣除非经常性损益	基本每股收益(元/股)	1.45	1.40	1.37	1.40	1.51	1.55
	稀释每股收益(元/股)	1.45	1.40	1.34	1.34	1.47	1.47
加权平均净资产收益率	34.39%	19.35%	15.12%	17.28%	16.50%	18.84%	
加权平均净资产收益	33.34%	18.76%	14.66%	16.75%	16.00%	18.27%	

率（扣除非经常性损益）					
-------------	--	--	--	--	--

（三）本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险提示

本次发行后，投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而公司本次公开发行可转债募集资金使用至为公司带来经济效益需要一定的时间周期，因此短期内可能对公司净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。

另外，本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

因此，公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

二、董事会关于本次公开发行必要性和合理性的说明

在全球电子信息产业快速增长的行业背景下，公司通过公开发行可转债募集资金投资于江西景旺高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）。本次公开发行可转债募集资金投资项目经过严格的论证，其实施具有必要性和合理性，相关说明如下：

（一）解决产能瓶颈，适应行业发展和满足市场需求

2014年至2016年，公司主营业务收入持续快速增长，年均复合增长率为21.15%。公司产能利用率已处于较高水平，2016年度公司综合产能利用率为95.06%，其中刚性电路板业务的产能利用率为96.83%。受到场地及资金的限制，公司难以迅速扩大产能。

随着公司市场竞争力的不断提升，并受到中国PCB产业稳步增长、产业整合加快、下游新兴产业需求增长等有利因素的影响，预计未来几年公司产品的市场需求将持续增长，产能不足的问题将日益凸显。

通过实施本次募投项目，公司将新增年产240万平米刚性板产能，较2016年

刚性板产量277万平方米，公司生产能力实现大幅提高，对于公司在稳定现有优质客户群的同时继续扩大市场占有率具有重要的意义。

（二）巩固市场地位，提升核心竞争力

根据中国印制电路行业协会的统计，2014年公司在中国印制电路行业排行榜中名列第19位，内资企业(内资持股超过51%)排名中位列第3位，市场占有率1.3%；2015年公司在中国印制电路行业排行榜中名列第14位，内资企业排名中位列第2位，市场占有率1.97%；2016年公司在中国印制电路行业排行榜中名列第10位，内资企业排名中位列第2位，营业收入相比2015年增长了22.63%。根据全球知名的调研机构N. T. information发布的全球PCB制造商排行统计数据，2014年~2016年公司排名全球第40名、34名和32名，排名稳步上升。

面对PCB行业良好的发展空间及未来我国快速增长的市场需求，国内的PCB厂商积极参与竞争，在质量、交期、规模等方面充分竞争。为了应对竞争压力，保持公司在国内外PCB行业的主要厂商地位，公司需要在经营规模、生产能力、产品结构与技术实力等方面进行全方位的提升。

本次募集资金投资项目实施后，公司在经营规模、产品档次、技术实力等方面将进一步发展，公司的核心竞争力与市场地位将得以巩固。

（三）实施自动化战略转型

本次募投项目通过对加强自动化生产设备投入，进一步扩大刚性电路板的产出，发挥规模效应，降低单位产品的成本。目前，国内人口红利正在消失，劳动成本增加，一定程度上阻碍了国内大量工业企业的可持续经营和发展。公司引入自动化生产线，降低管理费用和人力成本，跟随全球趋势走向信息化、自动化，结合公司二十多年的技术和人才积累，本次募投项目的设备精密化程度、自动化水平、生产流程的优化程度将有较大幅度的提升，随着募投项目的实施，公司经营规模将进一步扩大。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金项目与现有业务的关系

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，将全部投资于江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）。通过募投项目的实施，引进先进的生产设备，加强自动化生产设备投入，升级现有工艺流程，进一步扩大刚性电路板的产出，发挥规模效应，降低单位产品的成本，产品工艺流程和自动化水平将得到进一步的优化和提升，增强公司在经营规模、产品档次、技术实力等方面的核心竞争力，巩固公司的市场地位，增强公司长期可持续发展能力，全方面实现公司健康、均衡、持续的发展。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

募集资金投资项目运行所需的人员将以内部培养为主，部分基础工作人员将从外部招聘。公司在印制电路板生产、管理和销售等各个环节均培养和积累了大量的专业人员，同时建立了相关团队负责各项运营工作；相应的专业人员根据募集资金投资项目的实施计划从公司各对应部门提前确定，使得募集资金投资项目拥有充足的人力储备；同时公司对新招聘的员工进行培训和在生产管理上实行以老带新制度，确保相关人员能够胜任相关工作。

2、技术储备

公司经过二十年的发展，锐意进取，不断开拓，目前已发展成一家专业从事印制电路板研发、生产和销售业务的国家高新技术企业。公司是中国印制电路行业协会的副理事长单位，是行业标准的制定单位之一。公司作为国家高新技术企业，于2006年建立技术研发中心，于2015年成立中央实验室，逐步健全了公司的研发体系。公司已取得多项专利成果，并在生产经营过程中积累了丰富的非专利技术；公司建立应用技术创新激励机制，鼓励员工在基础应用技术的不断创新，优化生产流程和提高生产效率，公司具备较强的研发技术水平和管理能力，为项目的顺利实施提供重要的技术保障。

3、市场储备

公司经过多年的稳健经营，凭借良好的产品品质和服务水平，全面融入全球电子信息供应链，储备了广泛而优质的客户群体，这些客户多数为国内外知名电子生产厂商，同时公司处于上述客户的主要供应商。公司下游客户广泛分布在通讯设备、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制及医疗等行业，抗单一行业波动风险的能力较强。公司客户包括天马、信利集团、维沃（vivo）、海拉、华为、中兴、冠捷、霍尼韦尔、亚旭、罗技、ICAPE、POWER-ONE等国内外知名企业，这些客户普遍对供应商的资质要求高，体系认证周期长。同时，公司注重与客户建立长期战略合作关系，与重点客户已合作多年，业务关系稳定，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等称号。广泛的客户数量及高品质的客户资源为募投项目建设投产奠定良好的市场基础。

四、关于填补摊薄即期回报所采取的措施

（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况，发展态势

公司现有业务板块主要是印制电路板的研发、生产和销售业务，主要产品种类包括刚性电路板、柔性电路板（含贴装）和金属基电路板。2014年至2016年，公司主营业务收入持续快速增长，年均复合增长率为21.15%。目前公司产能利用率已处于较高水平，公司主要业务呈逐年稳步增长的良好发展态势。

2、面临的主要风险及改进措施

（1）人才储备无法满足业务规模扩大需要的风险及措施

近年来，公司经营规模迅速扩大，营业收入大幅提高，对公司管理、技术、市场营销等各方面提出更高的要求，要求公司能保持员工稳定性，并不断引进和培养管理人才、技术人才、市场营销人才。若未来公司不能引进和培养足够的人才，或现有人员出现较大流失，将会对公司生产经营的稳定性产生影响。

针对该情况，公司将重视人力资源对公司发展的战略影响，持续夯实高绩效

组织建设，打造创新业务团队，强化创新、高绩效文化，深化创新激励机制，持续激发员工的创业热情。聚焦新技术新工艺、自动化信息化趋势、高端职位等关键人群的获取和培养，向以支撑知识创造为核心的管理体系优化，提升人力资本准备度，为公司持续发展提供人才储备和保障。

（2）原材料价格上涨风险及措施

公司直接原材料占营业成本的比例较高，包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、金盐等主要原材料，这些主要原材料价格波动会对公司经营业绩产生一定的影响。2016年下半年以来，由于上游铜箔生产企业部分产能转移至锂电铜箔导致产能紧张，加上玻纤布产能因修窑炉影响而供应紧张及大宗原材料上涨等叠加因素，造成原材料价格上涨。

为应对原材料价格变化，公司督促管理层与主要原材料供应厂商建立并保持良好的合作关系，进一步发挥优势平台的议价能力；同时，优化内部管理、提升生产效率，采取持续提升产品良率、深入执行成本控制工作降低成本，依托公司较为优异的客户结构和产品结构将成本上涨的压力转移等措施降低原材料价格上涨带来的影响。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

为降低本次公开发行可转债摊薄即期回报的影响，公司拟采取以下措施提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩：

1、借助信息化系统，深入开展精益生产和成本控制等工作，确保公司经营效益的稳步提升

近年来，公司引进的“甲骨文（Oracle）”ERP上线使用，经过不断的模块完善、功能提升，经营管理大数据平台得到进一步的完善，管理效率、决策支持数据的准确性得到大幅度提升，为公司及时有效的应对市场变化提供有力的数据分析和工具。

公司将持续通过员工技能培训、引进自动化设备、深入进行生产流程优化、广泛组织进行应用技术创新等精细化管理工作，提升公司各产品线的生产效率。

公司已制定严格的成本控制指标，由董事会指导并督促成本控制指标的落实。公司各产品事业部将持续深入开展拼版设计、技术研发、BOM选料及流程优化等工作，严格按照ERP发料标准执行，使产品在前期采购、计划投料、生产领用时有章可循，减少物料呆滞和非正常消耗。此外，通过进一步完善成本统计与核算制度，对生产各工序的物料、能源、人工耗用、库存周转率和呆滞库存等进行统计并核算，形成成本控制建议，督促减少各工序设备和原料的不合理使用情况。通过不断加强精益生产并严格执行成本控制管理工作，较好地控制公司的生产成本，确保公司经营效益的稳步提升。

2、保证募集资金有效合理使用，加快募集资金投资项目进度

本次公开发行可转债募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于江西景旺高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）。通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步提升公司生产能力、提高生产效率以及整体运营能力。随着募投项目效益地逐步释放，将带动公司营业收入持续增长，从而提升公司效益，更好地回报投资者。本次募集资金到位后，公司将严格按照公司《募集资金管理制度》及相关法律法规规范使用募集资金，加快本次募集资金投资项目进度的建设，使得募集资金得到充分利用。

3、重视品质管理，提升产品品质

产品质量稳定，是赢得市场和客户的基础，也是公司的主要竞争优势之一。公司继续坚持并贯彻品质优先原则，确保将品质优先的管理理念深入基层，为客户提供最满意的产品。公司各产品事业部持续完善考核机制，按照要求细化考核指标、分解落实，将品质考核列入相关员工绩效考核项目，提升全员的品质意识，严格按照规范操作，落实并做好品质管理。

五、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会在制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。

六、公司控股股东、实际控制人出具的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人均已出具了关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

七、对于本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险提示

本次公开发行可转债完成、募集资金到位后，在转股期内公司的总股本和净资产可能会得到进一步增加。由于本次公开发行可转债募集资金使用至为公司带来经济效益需要一定的时间周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司净利润的增长幅度低于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现下降，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。虽然公司已为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017年9月6日